

マイクロフォーカスX線CT装置では、非破壊で試料の内部を観察し、得られたCT画像から座標計測や欠陥解析を行うことができます。

試料にコーンビームX線を照射して、試料の厚みや密度、材質の違いを反映した透過画像および断面画像（CT画像）をミクロンオーダーの高分解能で作成する装置です。

電子部品や実装部品の非破壊検査、電池やセラミックスの欠陥検査など、工業製品の品質管理、不良解析に活用できます。

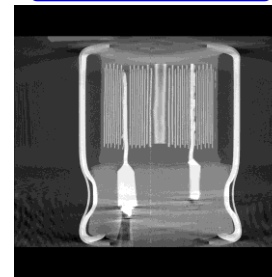


メーカー名：株式会社島津製作所
型 式：inspeXio SMX-225CT FPD HR

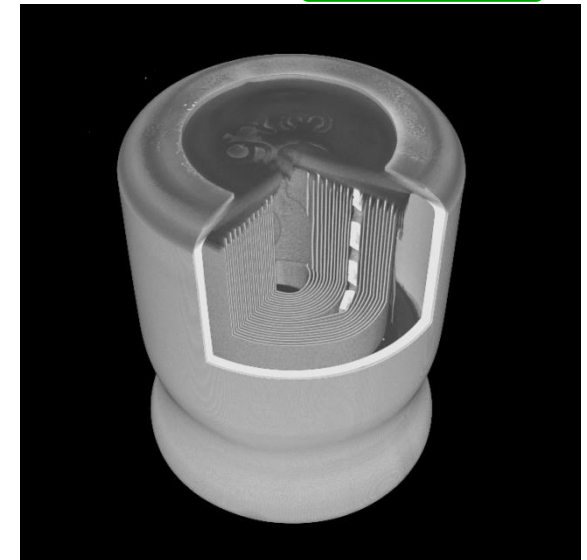
<撮影例>



電解コンデンサ



断面画像



三次元画像(一部を撮影データ上でカット)

空間分解能：4 μm (撮影条件で変わります)
CT撮影領域：最大 ϕ 300 mm × H 450 mm
三次元画像処理：3D表示、座標計測及び欠陥解析機能

対象の内部を非破壊で非常に高分解能(最高4 μm)で撮影することができます。
撮影データを三次元的に表示できます。